

TIF®050AB-11S 是一款高导热液态间隙填充材料，采用双组分设计，具备依温度调整固化时间的特性。其柔韧且具弹性的材料特性，使其能紧密贴合不平整表面，将热量有效导出至金属外壳或散热板，提升电子元件的散热效率与使用寿命。液态形态可灵活提供不同厚度，取代传统导热垫片的模切限制。

特性

- 》良好的热传导率：5.0 W/mK
- 》双组份材料，易于储存
- 》优异的高低温机械性能及化学稳定性
- 》适用于低压力环境
- 》可依温度调整固化时间
- 》可用自动化设备调整厚度

应用

- 》计算机硬件
- 》通信设备
- 》汽车用电子设备
- 》导热减震设备
- 》散热片及半导体

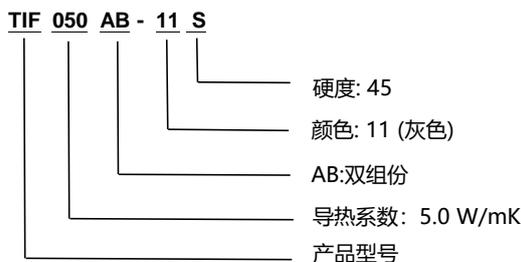
TIF® 050AB-11S 系列特性表

未固化材料特性		
性质	典型值	测试方法
A组份颜色	白色	目视
B组份颜色	灰色	目视
A组份粘度 (mPa·s)	2,800,000	GB/T 10247
B组份粘度 (mPa·s)	3,000,000	GB/T 10247
挤出量 (g/min)	6.0	兆科测试 (50 cc针筒/ 管口直径 1.5 mm/ 90 psi)
密度 (g/cc)	3.2	ASTM D297
最小界面厚度 (mm)	0.2	兆科测试
热阻抗 @10psi (°C·in ² /W)	0.76	ASTM D5470
热阻抗 @50psi (°C·in ² /W)	0.67	ASTM D5470
混合比例	1:1	-
保质期	12 个月	-
固化条件		
操作时间 25°C	30 分钟	兆科测试
固化时间 25°C	60 分钟	兆科测试
固化时间 70°C	30 分钟	兆科测试
固化后材料性能		
颜色	灰色	目视
硬度 (Shore OO)	45	ASTM D2240
建议工作温度 (°C)	-45~200	兆科测试
击穿电压 (V/mm)	≥5500	ASTM D149
阻燃等级	V-0	UL 94
导热系数 (W/mK)	5.0	ASTM D5470

产品规格

50 cc/支, 48 支/箱 或 400 cc/支, 9 支/箱, 或在注射器用于自动化应用定制包装。如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

产品型号说明



全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com
 www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。

